



华微电子
SINO-MICROELECTRONICS

有害物质控制管理程序

编号: Q/IGD.H4101

版本号: A/3

机密等级: C 级

第 1 页共 31 页

发布日期:		生效日期:			
文件修订状态					
修订日期	文件版本	修订页		修订内容	修订者
		页次	版本		
2010-2-24	A/1	全部	A/1	1. 生产制造部变更为生产管理部，总经理办公室和设备管理部取消，相关职能变更到人力资源部和生产管理部。 2. 附件一按 SONY SS-00259 标准第八版要求和新增 14 种 SVHC 更新《环境管理物质控制标准》。	马凤新
2010-12-27	A/1	全部	A/2	附件一《环境管理物质控制承诺书》中新增： 1. 第三批 8 种 SVHC，第四批 8 种 SVHC，更新《环境管理物质控制标准》 2. 第 4 条环保标识要求。	马凤新
2011-11-24	A/2	全部	A/3	附件一《环境管理物质控制承诺书》中新增： SONY SS-00259 标准第十版新增物质和第五批 7 种 SVHC，更新《环境管理物质控制标准》	马凤新



华微电子
SINO-MICROELECTRONICS

有害物质控制管理程序

编号: Q/IGD.H4101

版本号: A/3

机密等级: C 级

第 2 页共 31 页

拟制

	日期	部门	职位	姓名	备注
1	2009 年 6 月 25 日	安全保卫部	EHS 体系管理员	马凤新	
2					

会签

	日期	部门	职位	姓名	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

批准

	日期	部门	职位	姓名	备注
1					

 华微电子 SINO-MICROELECTRONICS	有害物质控制管理程序		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 3 页共 31 页

1. 目的

在生产制造全过程（包括采购、生产、销售、相关方活动），禁止或限制使用某些化学物质，以降低产品的环境负荷，减少产品生产过程中的环境污染，保护生态环境，满足客户的环保要求。

2. 范围

吉林华微电子股份有限公司原材料和备品备件采购、外协加工、生产、销售全过程。

3. 职责

3.1. 安全保卫部

- 3.1.1. 负责 HSPM 体系建设、审查；
- 3.1.2. 负责组织与外协厂家及原材料厂家签订 HS 控制协议；
- 3.1.3. 负责对相关方进行环境管理物质控制的审核和评价；
- 3.1.4. 负责环境管理物质控制相关法律、法规的识别，并进行公司内部管理文件的转化；

3.2. 技术工程部

- 3.2.1. 负责客户需求的 HSF 产品生产工艺设计、方案制定及变更；
- 3.2.2. 负责 HSF 控制相关标准的识别，并依此进行环境管理物质含量标准的制定；
- 3.2.3. 负责审核 HS 控制协议标准的相关技术和标准条款；
- 3.2.4. 负责掌握我公司产品中含有的 HS 种类或含量，并按照客户要求提供材料分析表；

3.3. 生产管理部

- 3.3.1. 负责组织生产单位按 HS 标准进行产品生产，负责外协产品按照 HS 标准进行生产；
- 3.3.2. 负责收集协议中要求的相关资料和环境管理信息的沟通，并存档；
- 3.3.3. 负责控制外协无害产品的切换工作，制定无害产品的切换明细；
- 3.3.4. 按照客户要求提供外协产品材料分析表；

3.4. 质量管理部

- 3.4.1. 负责原材料及备品备件、成品及半成品的 HS 含量、相关包装标识的检验、跟踪；对于客户在环保产品包装标识上的特殊要求负责进行粘贴、检验、跟踪。
- 3.4.2. 负责组织 HS 控制体系建立的监督；
- 3.4.3. 负责生产现场过程（包括外协厂家）HS 的控制管理。

 <p>华微电子 SINO-MICROELECTRONICS</p>	<h1>有害物质控制管理程序</h1>		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 4 页共 31 页

3.4.4. 负责有关 HS 客户要求的信息反馈及收集。

3.5. 采购中心

3.4.1. 负责 HSF 材料采购;

3.4.2. 负责传递 HS 控制信息, 收集协议中要求的相关资料, 并存档, 同时交安保部备份。

3.6. 运营中心

3.6.1. 负责组织制定 HSF 生产计划, 不符合 HSF 要求的产品库存销售计划;

3.6.2. 运营中心负责统计不符合 HSF 的产品, 并区分、隔离存放;

3.6.3. 运营中心库房及销售业务员对有 HS 要求的客户进行严格的发货控制;

3.7. 人力资源部

3.7.1. 从法律角度对 HS 协议进行审核。

主管安全工作的总(副)经理负责公司安全检查的布置领导工作, 并负责隐患整改实施的检查工作。

4. 定义

无

5. 内容

5.1. 吉林华微电子股份有限公司对 HS 的控制实施全过程管理, 包括原材料和备品备件采购、外协加工、设计、生产、销售全过程;

5.2. 吉林华微电子股份有限公司对 HS 的管理按照三个级别进行控制:

5.2.1. 一级管控:

参见《HS 环境管理物质清单》具体的控制方法:

- 在指定用途范围内, 零部件和材料中禁止含有;
- 在生产过程中控制因设备或辅助材料含有此类有害物质, 而对产品造成污染;
- 提供有效的检测报告, 并实施过程检测;
- 供应商承诺;
- 实施有效的控制措施;

5.2.2. 二级管控:

- 在指定用途范围内, 主要原材料(组成原材料)中禁止含有;
- 供应商承诺;



5.2.3. 三级管控:

- 登记备案。

5.2.4. HS 控制标准

我公司环境管理物质控制按照 SONY SS-00259 标准进行控制。参照《HS 物质清单及其检测标准》, 制定如下清单:

HS 环境管理物质清单

序号	有害物质名称	使用对象	所对应之零件	管理级别	管制标准	状态确认
1	镉以及其化合物	晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件; 塑封料; 脱模剂; 清膜剂; 粘片焊料; 导电胶; 焊锡; 助焊剂; 引线框架; 聚酰亚胺; 金丝; 铜丝; 铝丝; 电镀材料; 包装材料;	1 级	不超过 5 ppm	无使用
2	铅以及铅化合物	晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件; 塑封料; 脱模剂; 清膜剂; 粘片焊料; 助焊剂; 引线框架; 聚酰亚胺; 金丝; 铜丝; 铝丝; 电镀材料; 包装材料;	1 级	不超过 100 ppm	纯锡条(球)中含有, 但不超标
3	汞以及汞化合物	晶体管封装材料、包装材料、表面处理材料	电子元器件; 塑封料; 脱模剂; 清膜剂; 粘片焊料; 助焊剂; 引线框架; 聚酰亚胺; 金丝; 铜丝; 铝丝; 电镀材料; 包装材料;	1 级	禁用	无使用
4	六价铬化合物	塑料(包括橡胶)、涂料、墨水	电子元器件; 塑封料; 脱模剂; 清膜剂; 粘片焊料; 助焊剂; 引线框架; 聚酰亚胺; 金丝; 铜丝; 铝丝; 电镀材料; 包装材料;	1 级	禁用	无使用
5	聚溴联苯(PBB)	用于塑料的阻燃剂等所有用途	塑封料	1 级	禁用	无使用



6	聚溴联苯醚	用于塑料的阻燃剂等所有用途	塑封料	1 级	禁用	无使用
7	PFOS、PFOA	电镀中的添加剂,油类	电镀 油类等辅材	1 级	<1000ppm	无使用
8	锑及其化合物	塑料中的阻燃剂	环氧塑封料	1 级	<900ppm	无卤产品(塑封料)中不含
				3 级	---	普通塑封料中含有此物质含量大约为 0.5%~2%
9	卤素(F,Cl,Br,I)	塑料中的阻燃剂	环氧塑封料,导电胶	1 级	(无卤产品中) Cl<700ppm Br<700ppm Cl+Br<1000ppm。	无卤产品(塑封料)中不含
				3 级	---	普通塑封料中含有
10	包装材料中的镉、铅、汞、六价铬		包装材料	1 级	总和不超过 100 ppm	包装材料
11	聚氯乙烯(PVC)及其混合物		塑封料	3 级	---	料管类包材
12	多环芳烃类(PAHs)		塑封料	2 级	禁用	无使用
13	双酚 A		塑封料	2 级	禁用	无使用
14	特定邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP)		塑封料	2 级	禁用	无使用
15	REACH 第 1 批 15 种 SVHC		塑封料	2 级	<1000ppm	无使用
16	REACH 第 2 批 14 种 SVHC		塑封料	2 级	<1000ppm	无使用



17	REACH 第 3 批 8 种 SVHC		塑封料、引线管脚	2 级	<1000ppm	无使用
18	REACH 第 4 批 8 种 SVHC		引线管脚	2 级	<1000ppm	无使用
19	REACH 第 5 批 7 种 SVHC		塑封料、引线管脚	2 级	<1000ppm	无使用

注: * 当有环境管理物质管制标准或管理等级变更时, 要立即对变更的环境管理物质状态进行重新调查与评审, 并把状态调查内容填入此表中。

* 豁免要求参照欧盟第 2002 / 95 / EC 号指令。

5.3. 供应商和外协厂商的控制

5.3.1. 组成我公司产品的主要原材料, 必须符合我公司 HS 控制标准(包括一级和二级管控物质)。包括以下:

塑封料、脱模剂、清膜剂、粘片焊料、沾锡用锡条、油墨、助焊剂、清洗剂、硅单晶片、引线框架、键合丝、内涂料、包装(包括: 泡沫、塑料袋、纸盒(包括纸盒油墨)、条管、编带、胶带、捆绑带、标签、胶垫、缓冲材料、用于搬运的部分)。

5.3.2. 禁止采购含有 HS 的零部件或材料, 禁止在外协加工过程中引入 HS。

5.3.3. HSF 合格供应商和外协厂商的认证:

- 在开发新的材料供应商和外协厂商时, 应按《供应商管理程序》和《封装外包管理程序》进行。供应商和外协厂商送样时需附以下资料:
- 指定第三方检测机构(SGS, ITS)最新的《检测报告》,《检测报告》的有效期为一年。
- 《环境管理物质控制承诺书》、《零/部件或原材料成份展开表》、《有害物质调查表》。
- 《MSDS》物质安全数据表(化学危险品、塑封料、粘片焊料等供货商提供)。
- 符合 ROHS 要求的样品。
- 其他所必须材料(供应商管理程序所要求的)。

5.3.4. 认证合格后, 应建立合格供应商和合格外协加工方名录。

5.3.5. 要求供应商、产品外协厂家等相关方, 建立环境管理组织机构、管理体系和制度, 并对我公司进行 HS 控制保证承诺;

5.3.6. 要求供应商或外协加工商, 应提供 HS 含有清单, 包括其含有量、含有部位、

 华微电子 SINO-MICROELECTRONICS	有害物质控制管理程序		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 8 页共 31 页

含有用途等相关信息;

- 5.3.7. 供应商应每年进行一次 HS 检测，检测的材料和零部件，应从贵公司的出货成品中抽出（必须为同工艺、同材料、同型号的产品），送检机构应为国际上权威检测机构 SGS 或 ITS，并将检测报告提供给我公司。
- 5.3.8. 供应商和外协厂商的生产工艺或原材料发生变更时，要及时通知我公司。
- 5.4. 当发生以下情况时，应立即对供应商、外协厂商重新认证。
 - 5.4.1. 产品原材料更换（包括更换厂家、种类、型号）
 - 5.4.2. 设备更换
 - 5.4.3. 工艺调整
 - 5.4.4. 出现环境事故
 - 5.4.5. 被第二、三方投诉时
- 5.5. 生产过程中 HS 控制
 - 5.5.1. 生产过程中影响产品 HS 的过程，包括芯片包装、芯片运输、粘片、后处理、沾锡、清洗、测试、压线、包封、包装、打印、库存等过程。
 - 5.5.2. 根据现场生产过程情况，按照《HSPM 风险评估管理程序》对影响 HS 的因素进行辩识和识别，并制定相应的控制措施。
 - 5.5.3. 生产 HSF 产品的人员均需要经过培训，符合生产环保订单的操作技能和环保意识。
 - 5.5.4. 对用于生产使用的工夹器具，设备（设备与产品接触的部分、无铅波峰焊，电批，烙铁等）均需要对其进行环保控制。
 - 5.5.5. 在生产过程中不得随意更换原材料，辅助材料，工夹器具或设备，也不得随意添加有机溶剂等杂质。
 - 5.5.6. 生产单位严格按标准的操作程序和设定的条件进行操作，定期点检及保养。
 - 5.5.7. 确保主要原材料、设备、工夹器具、辅助材料及辅助化学溶剂，如硅油，脱模剂，稀释剂，助焊剂，信那水，油漆，油墨等在制程中不受到污染，所有设备、工夹器具在使用前都必须被处理和确认，避免含有环境管理物质而造成污染。
 - 5.5.8. 生产时需实行严格的批次管理，具体要求按《标识和可追溯性管理程序》执行。批次管理确保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，库存品，供货商，生产线别，生产人员，生产的设备等。
 - 5.5.9. 对于生产现场存在非环保产品时，必须设置专用的设备、工夹器具和存储区域，做好环保产品和非环保产品的隔离。包括使用设备的隔离、存储地点的隔离、处理工艺的隔离。如果做不到设备和工夹器具的隔离，必须在切换前进行清洗，

 华微电子 <small>SINO-MICROELECTRONICS</small>	<h1 style="text-align: center;">有害物质控制管理程序</h1>		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 9 页共 31 页

保证不被污染。

5.5.10. 要定期对生产线或库存产品进行检测，具体控制方法见《产品监视和测量管理程序》。

5.6. HS 协议或承诺

5.6.1. 客户对我公司的 HSF 要求，经市场部反馈我公司后，由市场部填写《技术、质量、HSF、EHS 协议》，依次传递相关部门。

5.6.2. 签订 HS 协议或承诺应在两天之内会签结束，如市场部要求时间紧迫，在会签表上标明时间，安保部安排人全程进行跟踪，必要时召集相关部门进行会议会签。

5.6.3. 对于符合我公司要求的合格原材料供应商、外协加工厂商，应要求其出具符合我公司 HS 控制标准的协议或承诺书。

5.6.4. 客户 HS 承诺书异议的处理

5.6.4.1. 在承诺书或协议的签订过程中，如出现异议或发现问题，应由相关部门提出建议或应对措施。安全保卫部负责提出 HSF 方面法律、法规条款的沟通建议，技术工程部负责产品 HSF 含量、成份方面的沟通建议，人力资源部负责提出协议法律符合性的沟通建议，质量管理部负责提出我公司产品含量超标问题的沟通建议，并以文字的形式传给相应的客户。

5.6.4.2. 如果客户提出我公司 HSF 清单以外的物质时，被视为特殊 HSF 要求，对于特殊 HSF 要求，应进行评审，且由技术工程部确认我公司产品是否含有此类物质。

5.6.4.3. 技术工程部根据市场部反馈的信息，对于判定我公司产品中是否含有特殊 HSF 的物质。如不能判定，应拿出解决方案，或者对我公司产品进行 SGS 检测；或者对供应商进行调查。

5.6.5. 对于重要客户提出的 HSF 要求，如信函、电话沟通仍不能解决问题，可以由市场部业务员组织相关技术、管理人员进行现场沟通。

5.6.6. 如沟通仍不能解决问题，组织技术工程部、生产管理部、质量管理部、安保部、采购中心等相关部门进行会议评审，并做好会议记录。

5.6.7. 在评审结束后，安保部将评审内容和相关控制措施，要以书面的形式，反馈给相关部门，由责任部门制定控制解决方案。

5.7. HS 不符合的处理:

5.7.1. 供应商原材料及外协产品不合格:

质量管理部对原材料及外协产品进行检测，如发现不合格，将通过书面的形式

 华微电子 SINO-MICROELECTRONICS	有害物质控制管理程序		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 10 页共 31 页

告之供应商或外协厂家。同时,将此批货物或产品送第三方检测机构进行检测,如确认为 HS 不合格品,则对该批次原材料或产品按照 5.9 条款要求处理。

5.7.2. 生产过程中发现不合格品时,应在生产现场停止此批产品的传递,并放置在 HSF 不良区域内,且书面联络相关部门。

5.7.3. 客户 HS 问题反馈,参照《客户投诉管理程序》。

5.7.3.1. 当发现 HS 异常时,包括原材料异常、生产工艺过程异常、产品异常,应立即逐级汇报给环境管理物质负责人,并以反馈单的形式通报给相关责任人,按照《不合格品管理程序》进行处理。

5.7.3.2. 当客户提出 HS 抱怨时,应由市场部将该产品的型号、批次等信息传递回我公司,由质量管理部根据《客户投诉管理程序》进行处理。

5.7.3.3. 由质量管理部组织相关人员召开环境管理物质分析会议,进行原因分析,制定整改措施,质管部对其相应回避进行跟踪。

5.7.3.4. 进行整改时,应考虑到本批次所有产品,包括:库存品、在制品、不良品、客户处产品、在运输途中的产品,对这些产品进行追溯。

5.8. HS 控制的审核

5.8.1. 供应商、外协厂商的审核

5.8.1.1. 对供应商或外协厂商的审核形式,包括现场审核、信函调查、二方审核。

5.8.1.2. 我公司每年将不定期对供应商提供的零部件或材料中 HS 的含量进行检测,以核对供应商提供数据的可靠性,如检测不合格,按照 5.9 条款给予处罚,严重的应追究法律责任。

5.8.1.3. 对涉及 HS 的供应商、外协厂商应定期(每 1-2 年)进行现场审核或其它方式的审核,审核应留有记录,并提出审核结果报告。

5.8.1.4. 各相关部门负责督促 SGS 报告的更新,并保持有效,安保部每月跟踪采购中心及生产管理部相关资料及报告的更新情况;

- 供应商材料有害物质登记表随时更新,且每年更新一次;
- 供应商环保声明,跟随法律法规和我公司制度的变化,进行更新;
- 合格供应商名单及合格外协厂家名单,随时更新。

5.8.1.5. 当出现以下情况时,应立即对供应商进行审核;

- 我公司对原材料抽测结果不合格;
- 客户反馈我公司产品有问题,与之相关联的供应商;
- 供应商的原材料或工艺变动时;

5.8.1.6. 审核后,安保部应提出审核意见(即保留、保留须改进、解除商务关系),

 <p>华微电子 SINO-MICROELECTRONICS</p>	<h1>有害物质控制管理程序</h1>		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 11 页共 31 页

并将建议传递给原材料供应商或外协厂家;

5.8.2. 生产现场环境管理物质控制的审核

生产现场的 HS 审核每年至少进行一次, 审核前应制定审核检查表, 由 HSF 体系内审员进行。

5.9. 环保违规处罚:

5.9.1. 原材料及外协产品违规处罚

5.9.1.1. 我公司对原材料或外协产品进行抽测, 如有害物质超过我公司管理标准, 但未对我公司造成任何影响, 我公司会及时将此信息通报相应的供应商或外协厂家, 并将此批次的产品送至共同认可的第三方检测机构进行重新检测, 如检测合格, 以此合格报告为准。如检测不合格, 要求供应商或外协厂家提交原因分析及整改措施, 并且, 供应商或外协厂商需支付违约金 5 – 10 万元。

5.9.1.2. 如果客户反馈某种产品环境管理物质超标, 我公司会将此信息传递给所有有关供应商或外协厂家, 并对相同批次和型号的(从留样中, 或从最近的批次进行抽测)原材料或产品进行抽测, 如经验证是某供应商或外协厂商的问题, 则供应商或外协厂商应承担全部责任和赔偿。

5.9.1.3. 客户反馈或我公司抽测发现有害物质超过欧盟 ROHS 标准, 则对此批产品或原材料全部销毁, 如对我公司造成影响, 供应商或外协厂商应赔偿所有损失, 并支付违约金 10 万元。

5.9.1.4. 供应商或外协厂商未按照我公司规定的时间提交所要求的 ROHS 资料, 或提供虚假资料, 未对我公司造成任何影响, 视情节需支付违约金 2000 至 10000 元; 已经造成影响, 赔偿我公司全部损失, 并支付违约金 5 万元。

5.9.2. 供应商或外协厂商出现以上环保违规情况后, 直至在此问题彻底解决前, 对其货款进行冻结。

5.9.3. 我公司将违约金信息传递给供应商或外协厂商, 待其确认后, 直接从货款中扣除。违约金确认信息单发出 15 日后(以 EMS 邮寄日期为准), 如相关方无信息回馈, 即视为接受。

6. 支持文件

- 《供应商管理程序》
- 《封装外包管理程序》
- 《产品监视和测量管理程序》

 华微电子 SINO-MICROELECTRONICS	有害物质控制管理程序		
编号: Q/IGD.H4101	版本号: A/3	机密等级: C 级	第 12 页共 31 页

《标识和可追溯性管理程序》
 《客户投诉管理程序》。
 《不合格品管理程序》
 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》(RoHS 指令)
 (2002/95/EC)
 《欧盟关于报废电子电气设备的指令》(WEEE 指令) (2002/96/EC)
 《欧盟关于包装以及包装废弃物的指令》(94/62/EC)
 《欧盟关于镉的限制使用的指令》(91/338/EEC)
 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(Montreal Protocol)
 《欧盟关于危险品的分类、包装和标记的指令》(67/548/EEC)
 《关于某些危险物质和制剂限制销售和使用的指令》(76/769/EEC)
 SONY SS-00259 标准

7. 相关记录

序号	记录名称	记录编号	保管部门	保存期限	机密等级
1	《零/部件或原材料成份展开表》	Q/IGD.H4101-01	技术工程部	3 年	C 级
2	《MATERIAL CONTENT DECLARATION FORM》	Q/IGD.H4101-02	技术工程部	3 年	C 级
	《有害物质调查表》	Q/IGD.H4101-03	技术工程部	3 年	C 级

8. 附录

- 附录 1: 《环境管理物质控制承诺书》
- 附录 2: 我公司对外承诺《环境管理物质控制承诺书》
- 附录 3: SONY SS-00259 标准